

令和3年度

京都実装技術研究会 オープニングセミナー

京都実装技術研究会は、昭和62年に発足し、電子機器の生産に深く関わる基盤技術である接合・実装技術を中心に、生産現場の高度化のために必要な課題や各社が抱えている共通の問題をテーマにした活動を行い、参加企業の技術水準向上に努めています。

この度、令和3年度の会員募集に先立ち、参加費無料のオープニングセミナーを以下のとおり開催します。

◇ 開催日時 令和3年5月25日（火） 13:30～17:00

◇ 開催方式 Web／会場参加 併用（講師はWebでのご講演です）

◇ 会場 京都府産業支援センター 5階 研修室
（京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク東地区内）

◇ 内容

①【最新半導体事情～米中問題から車載用IC不足まで】

国際技術ジャーナリスト兼セミコンポータル編集長 津田 建二 氏

再び半導体が注目されています。AIやDX（デジタルトランスフォーメーション）、5Gなどこれから成長が期待される分野には半導体が威力を発揮します。10年くらい前まで斜陽産業とまで言われた半導体ですが、実はこう言っていたのは日本だけでした。世界中の半導体産業はずっと連続的に成長してきました。半導体産業がどう変わってきて、今どういう状況なのでしょう。AIやDX、5G、さらには米中問題から最近の車載不足に至るまで、現状を解説します。

②【5Gの国内外の展開と産業応用動向】

エリクソン・ジャパン株式会社

チーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO） 藤岡 雅宣 氏

5Gは世界60箇国以上で商用導入され、日本でも2020年3月に商用化され徐々に普及してきています。5Gは、人が利用する通信サービスだけではなく様々な産業界での利用を目論んでいます。特に工場や港湾、空港、鉱山などでの導入が始まりつつあり、自動化や作業の効率化に役立つと期待されています。本講演では、5Gの仕組みや主な技術についてまとめた後、世界及び日本での5Gの展開状況や主なサービスについて概観し、今後期待される産業界での5Gのユースケースや5G利用で期待される恩恵についてまとめます。

◇ 定員 Web：応募状況により調整 会場：若干名

◇ 参加費 無料

◇ 申込締切 令和3年5月21日（金）まで

◇ 問合せ先 京都府中小企業技術センター 応用技術課 電気通信係
（京都実装技術研究会事務局）

TEL 075-315-8634

FAX 075-315-9497

E-mail jisso@kptc.jp

令和3年度 京都実装技術研究会 オープニングセミナー申込書

会社名			
所在地			
連絡担当者	所属・役職		
	氏名		
	E-mail		
	電話番号		
参加者	所属・役職	氏名	
参加方法	<input type="checkbox"/> Web 参加 <input type="checkbox"/> 会場参加		
研究会入会案内の送付を希望※1		<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない	

※1 すでに入会申込済みの方は「しない」にチェックを付けて下さい。

※2 申込書に御記入いただいた個人情報は、本研究会受講者名簿として活用させていただきます。

受講に当たっての注意点

- Web参加は、1事業所1接続でお願いします。複数名で参加される場合は、プロジェクターやスピーカー等のご準備をお願いします。
- 録画、録音等の配信データの記録、保存は一切禁止です。
- 会場には消毒液を設置し、会場の窓や扉の開放等による換気、他の受講者との間隔をあける等の対策をいたします。ご来所の際は、マスクの着用と丁寧な手洗い・手指消毒をお願いします。また、発熱等の症状がある方はご来場をお控えください。